卡夫特 K-5204

May. 2012. 更新

产品特点：

K-5204 有机硅导热胶既有粘接作用，又有优异的导热（散热）性。是一种经过补强的中性有机硅弹性胶，胶固化后有良好的耐高低变化性能，长期使用不会脱落，不会产生接触缝隙降低散热效果；因为有了补强，该胶有较高的粘接强度，剪切强度≥15 公斤/平方厘米。具有优异的耐高低温性能。它的使用温度范围为-60~280℃；该胶是一种单组分室温固化胶，用 100 毫升金属软管包装使用非常方便。

用途:

最主要的应用是代替导热硅脂（膏）作 CPU 与散热器、晶闸管智能控制模块与散热器、大功率电器模块与散热器之间的填充粘接。用此胶后可以除掉传统的用卡片和螺钉的连接方式，带来的结果是更可靠的填充散热、更简单的工艺、更经济的成本。

技术性能:

		性能名称	K-5204	K-5204K(快干型)
固化前		颜色	白色	白色
		粘度（cp）	触变糊状	触变糊状
		密度（g/cm^3）	2.5～3.0	2.5～3.0
		表干时间（25℃，min）	≤20	≤5
固化后	机械性能	抗拉强度(MPa)	≥2.5	≥2.5
		扯断伸长率（%）	≥100	≥100
		剪切强度（MPa）	≥1.5	≥1.5
		硬　度(shore A)	50～65	50～65
		使用温度范围（℃）	-60～280	-60～280
	电性能	介电强度（kV/mm）	≥18	≥18
		介电常数（@60Hz）	2.8	2.8
		体积电阻（Ω.cm）	1×10^{15}	1×10^{15}
	导热系数（w/(m.k)）		1.6	1.6

使用方法：

1、将被粘或被涂覆物表面整理干净，除去锈迹、灰尘和油污等。

2、拧开胶管盖帽，将胶液挤到已清理干净的表面，使之分布均匀将被粘面合拢固定即可。

3、将被粘好或密封好的部件置于空气中,让其自然固化。固化过程是一个从表面向内部的固化过程，在 24 小时以内(室温及 55%相对湿度)胶将固化 2-4mm 的深度,如果部位位置较深,尤其是在不容易接触到空气的部位,完全固化的时间将会延长,如果温度较低,固化时间也将延长。在作进一步处理或将被粘结的部件包装之前，建议用户等待足够长的时间以使粘合的牢固和整体性不被影响。

注意事项：操作完成后，未用完的胶应立即拧紧盖帽，密封保存。再次使用时，若封口处有少许结皮，将其去除即可，不影响正常使用。

包装规格： 80g/支，也可根据用户需要商定。

贮　　存： 贮存于阴凉干燥处，25℃以下保存期为 1 年

说明：以上数据是依据我们广泛实验所得，结果是可靠的。但由于实际应用的多样性，应用条件不是我们所能控制，所以用户在使用前需进行试验以确认本品是否适用。我公司不担保特定条件下使用我公司产品出现的问题,不承担任何直接、间接或意外损失的责任。用户在使用过程中遇到什么问题,可以和我公司技术服务部联系,我们将竭力为您提供尽可能的帮助。